

5-826926-0 ✓ AKTIV

AMPMODU | AMPMODU Headers

Interne TE-Nummer 5-826926-0

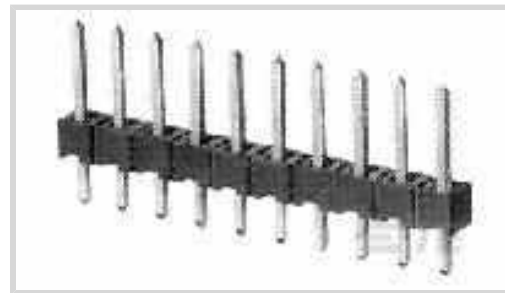
AMPMODU Headers, PCB Mount Header, Vertical, 50 Position, 2.54 mm [.1in] Centerline, Printed Circuit Board, Breakaway, 1 Row, Green

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplatten-Steckverbinder mit mehreren Konfigurationen >

Leiterplatten-Leisten und -Stecker mit mehreren Konfigurationen



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Anzahl von Positionen: **50**

Raster: **2.54 mm [.1 in]**

Kontakttyp: **Stift**

Eigenschaften

Produktmerkmale

| | |
|---|--|
| PCB-Steckverbindermontagetyp | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage |
| Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an | Leiterplatte |
| Stecksockeltyp | Abreißen |

Konfigurationsmerkmale

| | |
|---|---------------|
| Ladungszustand des Steckverbinderkontakts | Voll bestückt |
| Montageausrichtung für Leiterplatte | Vertikal |
| Anzahl von Positionen | 50 |
| Zeilenanzahl | 1 |

Elektrische Kennwerte

| | |
|----------------------------|--------|
| Spannungsfestigkeit (max.) | 1000 V |
|----------------------------|--------|

Sonstige Eigenschaften

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Profil des Steckverbinders | Standard |
| Pfostengröße | .63 mm[.024 in] |

Kontaktmerkmale

| | |
|--|--------|
| Länge des Gegensteckerpfostens | 6.7 mm |
| Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte | 2 µm |

| | |
|---|----------------|
| Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts | 2 µm |
| Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts | Zinn |
| Kontaktform | Quadratisch |
| Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte | Zinn |
| Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
| Kontakttyp | Stift |
| Kontakt-nennstrom (max.) | 5 A |

Klemmenmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Anschlussstift- und Restlänge | 3.2 mm[.1259 in] |
| Verbindungsmethode für Leiterplatte | Durchsteckmontage - Löten |

Montage und Anschluss-technik

| | |
|--------------------------------------|------|
| Zugentlastung | Ohne |
| Gegensteckführung | Ohne |
| Panelmontagevorrichtung | Ohne |
| Arretierung für Leiterplattenmontage | Ohne |

Gehäusemerkmale

| | |
|-----------------|----------------|
| Gehäusematerial | PBT GV |
| Raster | 2.54 mm[.1 in] |
| Gehäusefarbe | Grün |

Abmessungen

| | |
|--------------------|----------------|
| Row-to-Row Spacing | 2.54 mm[.1 in] |
|--------------------|----------------|

Verwendungsbedingungen

| | |
|---------------------------|--------------|
| Gehäusenenntemperatur | Standard |
| Betriebstemperaturbereich | -65 – 105 °C |

Industriestandards

| | |
|----------------------|----------|
| UL-Brandschutzklasse | UL 94V-0 |
|----------------------|----------|

Verpackungsmerkmale

| | |
|--------------------|--------------|
| Verpackungsmenge | 200 |
| Verpackungsmethode | Box & Carton |

Produkt-Compliance

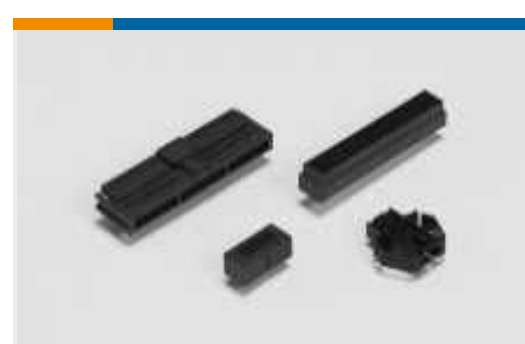
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

| | |
|--|---|
| EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU | Konform |
| EU ELV Richtlinie 2000/53/EG | Konform |
| China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 | Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte |
| EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 | Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019 (201) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2018 (181) Enthält keine SVHC |
| EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 | Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019 (201) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2018 (181) |
| Halogengehalt | Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm. |
| Lötfähigkeit | Wellenlötfähig bis 265 °C |

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA 'Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Auch serienmäßig | AMPMODU Headers



Anschlusswannen für Leiterplatten-Steckverbinder(1)



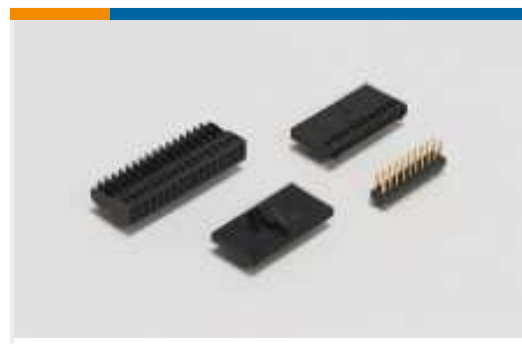
Laschen, Verriegelungen und Arretierungen für Leiterplatten(2)



Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -socket(1570)



Leiterplatten-Steckkontakte und -socket mit mehreren Konfigurationen (3808)



Leiterplatten-Steckverbindergehäuse
mit mehreren Konfigurationen(3)



Leiterplatten-Steckverbinderkontakte
in mehreren Konfigurationen(50)



Montage von Leiterplatten-
Steckverbindern(1)



Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und
Off-Road-Fahrzeuge(6)

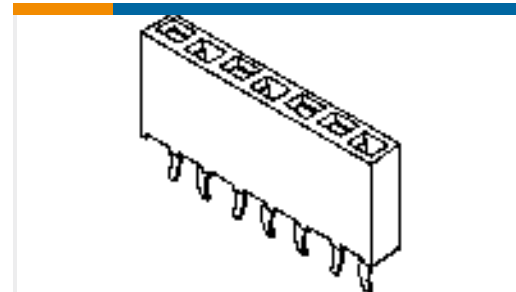
Kunden kauften auch diese Produkte



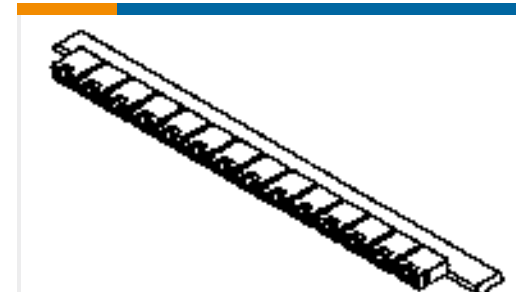
TE Teilenummer5-826632-0
AMPMODU II PIN HEADER 50P



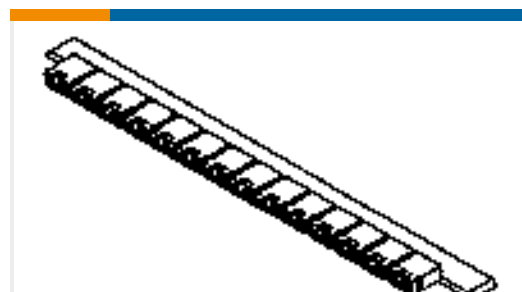
TE Teilenummer9-1879208-7
CPF 0402 100K 0.1% 25PPM 1K RL



TE Teilenummer2-215297-0
20P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE Teilenummer142270-3
CONNECTOR SHUNT 2 P



TE Teilenummer142270-1
CONNECTOR SHUNT 2 P



TE Teilenummer1623235-1
CRG0805 1% 47R



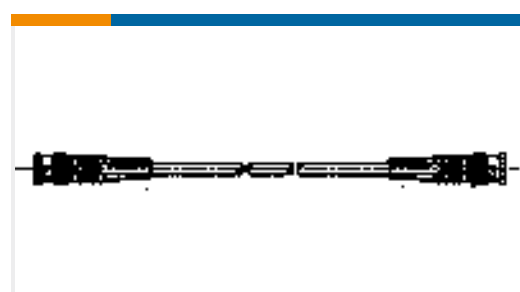
TE Teilenummer5-826925-0
50P MODU 2 PIN HDR.



TE Teilenummer1622831-1
CRG0603 1% 10R



TE Teilenummer5-826947-0
MOD2 PIN HEADER 50P



TE Teilenummer1337771-2
50 OHM COAX BNC STR PLUG STR P

Dokumente

Produktzeichnungen

[AMPMODU II PIN HDR.](#)

Englisch

[AMPMODU II PIN HDR.](#)

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_5-826926-0_O.2d_dxf.zip](#)



Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_5-826926-0_O.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_5-826926-0_O.3d_stp.zip](#)

Englisch

3D PDF

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Englisch

Freigabe Agentur

UL-Bericht

Englisch

UL-Bericht

Englisch